

Foundry Services

Service-Leistungen des IHT

Infrastruktur

- Reinraumfläche : 350 m²
- Reinraum-Klasse: 10000 bis 100
- Automatische Prozessanlagen
- Substratgröße bis 200 mm Durchmesser



Beschichtungsverfahren

- Aufdampf- und Sputter-Prozesstechnik:
 - Metallisierung: AlSi (1%), Al, Ag, Ni, TiW
- PECVD- Abscheidung: SiO₂, Si₃N₄
- MBE-Wachstum: Si, SiGe



Ätztechnologie

- Trockenätzverfahren: ICP, RIE
- Nasschemisches Ätzen:
 - Si, SiGe, SiO₂, Si₃N₄
 - Metalle
- Reinigungsverfahren



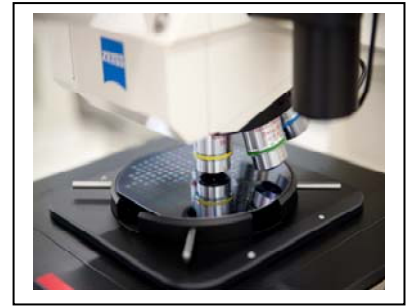
Lithographie

- Kontaktlithographie bis Substratgröße 150 mm
- e-beam Lithographie



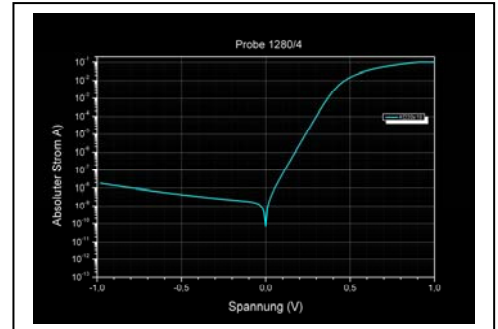
Schichtanalytik

- REM, AFM, μ Raman-Spektrometrie,
- Ellipsometrie, Reflektometrie,
- Profilometrie
- nasschemisches Defektätzen von dünnen Schichten,
- Tieftemperatur Hall- Messtechnik



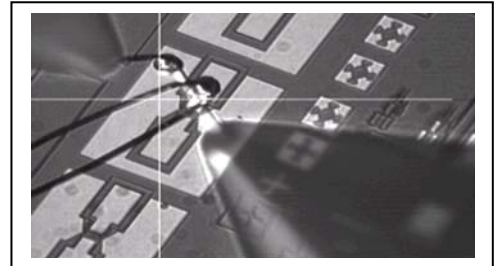
Messtechnik

- Bauelemente Charakterisierung
 - DC - Messtechnik
 - HF - Messtechnik bis 110 GHz



Aufbautechnik

- Sägearbeiten an Si-Wafer
- Bondtechniken
- Gehäuse Aufbautechnik



Service Center (Mechanik)

- Musterbau
- Werkzeuge für Waferhandling
- Einzel- und Kleinserienfertigung
- Sonstige mechanische Arbeiten auf Anfrage